



臻鼎科技控股

Zhen Ding Tech. Holding

臻鼎科技控股 (4958 TT)

投資人簡報

2025年03月

- 本簡報及同時發佈之相關訊息內，含有從公司內部與外部來源所取得的預測性資訊。
- 本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與這些預測性資訊所明示或暗示的預估有所差異，其原因可能來自於各種本公司所不能掌控的風險。
- 本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。



全球第1大

印刷電路板製造公司

2006年 成立
(前身華虹電子 1978)

台灣桃園 總部

48,141
2024年底員工數



29 座工廠

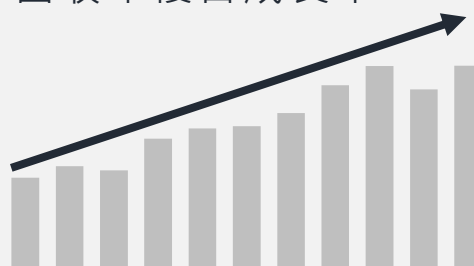
位於大陸、台灣、泰國、印度

NT\$1,716.6億

2024年營收(13.4% YoY)

+9%

2014-2024年
營收年複合成長率



1,868

累計有效獲證專利件數

3,866

累計專利申請
(截至2024年12月底)



NT\$1,086億

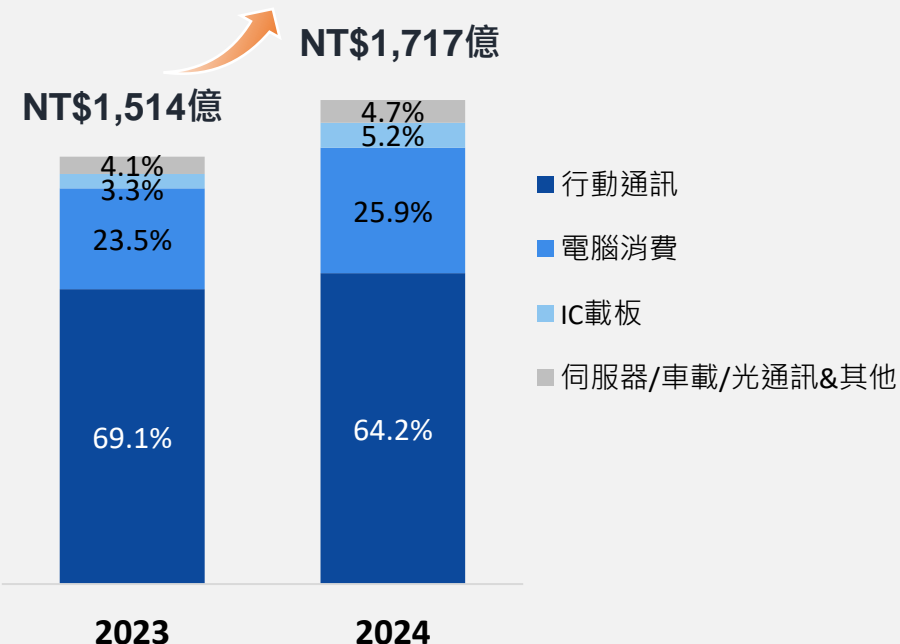
2025年3月10日市值

13.3%

10年平均股東權益報酬率
(2015-2024)

銷售分析 – 產品應用別

+13.4% YoY



為何投資臻鼎？

1

全球第一大PCB廠，長期穩健成長：

臻鼎自2017年起，榮登全球第一大PCB廠，2014-2024年營收年複合成長率達9%。

2

發揮One ZDT綜效，持續拉開領先差距：

以One ZDT為核心策略，發揮一站購足綜效，持續追求穩健成長。臻鼎2024年全球PCB市佔率為7.3%，目標2030年提升至10%。

3

積極拓展IC載板業務：

臻鼎目標IC載板營收2023-2027年複合成長率>50%，並目標2030年成為全球前五大IC載板供應商。

4

全球化生產基地：

除大陸三座主要生產基地，臻鼎在台灣、印度亦設有廠區，泰國新廠將於5/8試產、下半年小量產，同時規劃將高雄廠打造為AI園區，未來將持續拓展全球化生產基地，服務多元客戶需求。



臻鼎科技控股

Zhen Ding Tech. Holding

全球第一大PCB廠，長期穩健成長

1

2024年營收年增13.4%，優於原先預期並創下歷年新高，蟬聯第八年全球第一大PCB製造廠：

四大應用之中，包含行動通訊、伺服器/車載/光通訊、及IC載板皆創歷史新高，電腦消費亦顯著回溫，年增24.8%。在One ZDT策略下，臻鼎的產品線更加多元分散，伺服器/車載/光通訊與IC載板合計營收貢獻由前一年的7.4%提高至9.9%。整體而言，臻鼎全球PCB市佔率進一步由前一年的7.0%提高至7.3%。

2

2025年營收可望再創新高，AI相關產品營收占比將拉升至>70%：

儘管總體環境充滿變數，但邊緣AI裝置的快速崛起，包括AI手機、AI PC、智慧眼鏡、人形機器人、智能車等，正加速推動PCB技術升級與產品結構設計的變化，同時AI伺服器、光通訊與IC載板之高階產品亦將隨客戶需求放大。預期今年四大應用皆將成長，其中AI相關產品營收占比將拉升至>70%。

3

泰國新廠5/8試產，高雄AI園區將投資NT\$100億購置高階ABF載板與硬板設備，新廠效益明後年發酵：

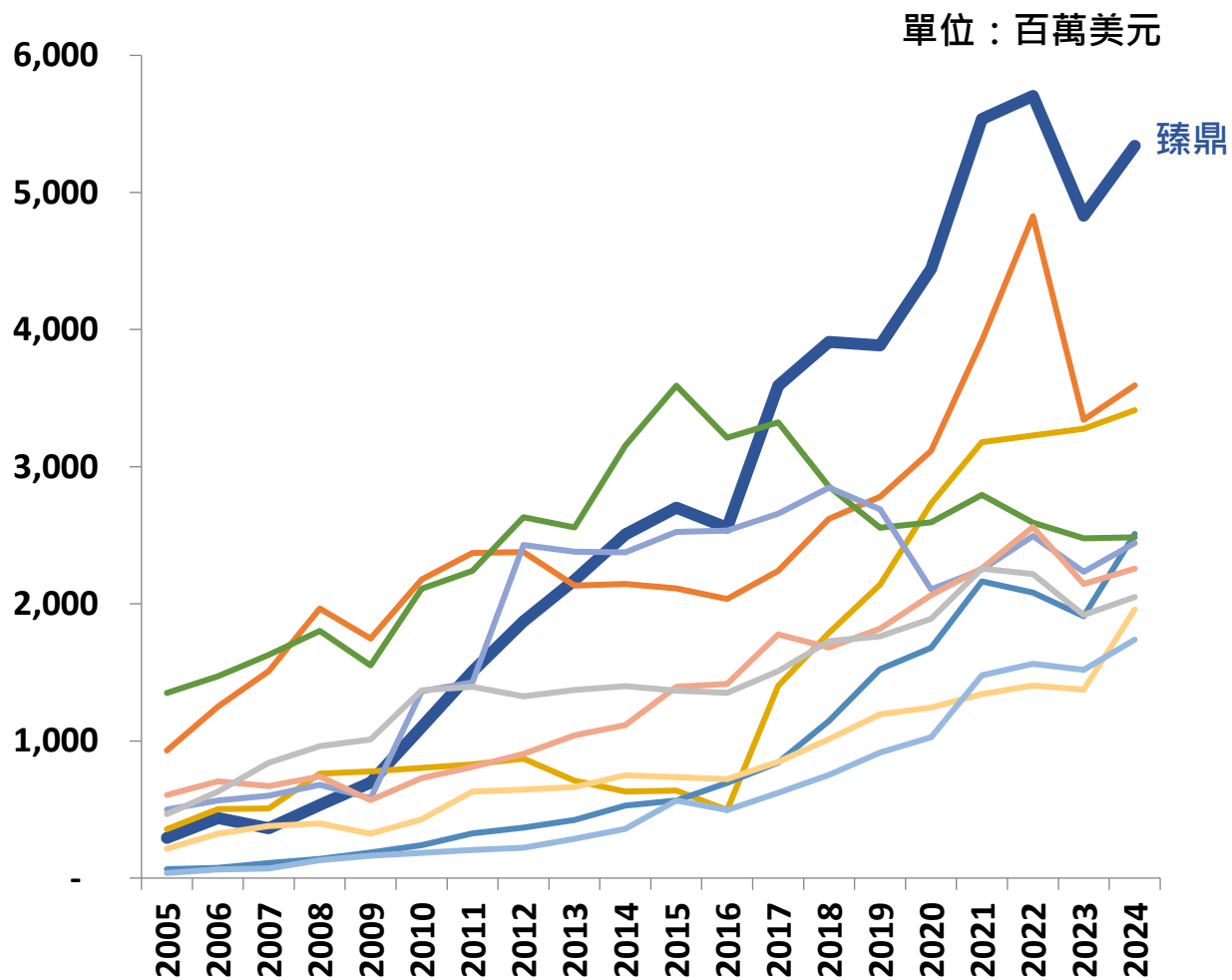
泰國新廠第一期將於5/8試產、下半年小量產，同時第二期廠房亦將於5/8動土，公司正積極投入資源、開拓新產品，爭取在泰國產能投產後順利切入更多一線客戶。同時高雄AI園區預計將投資新台幣100億購置高階ABF與硬板設備，預期泰國與高雄兩座新廠效益將於2026-2027年起逐步發酵。

4

聘請簡禎富擔任臻鼎總經理；董事長暨集團策略長、總經理、營運長組成鐵三角經營布局：

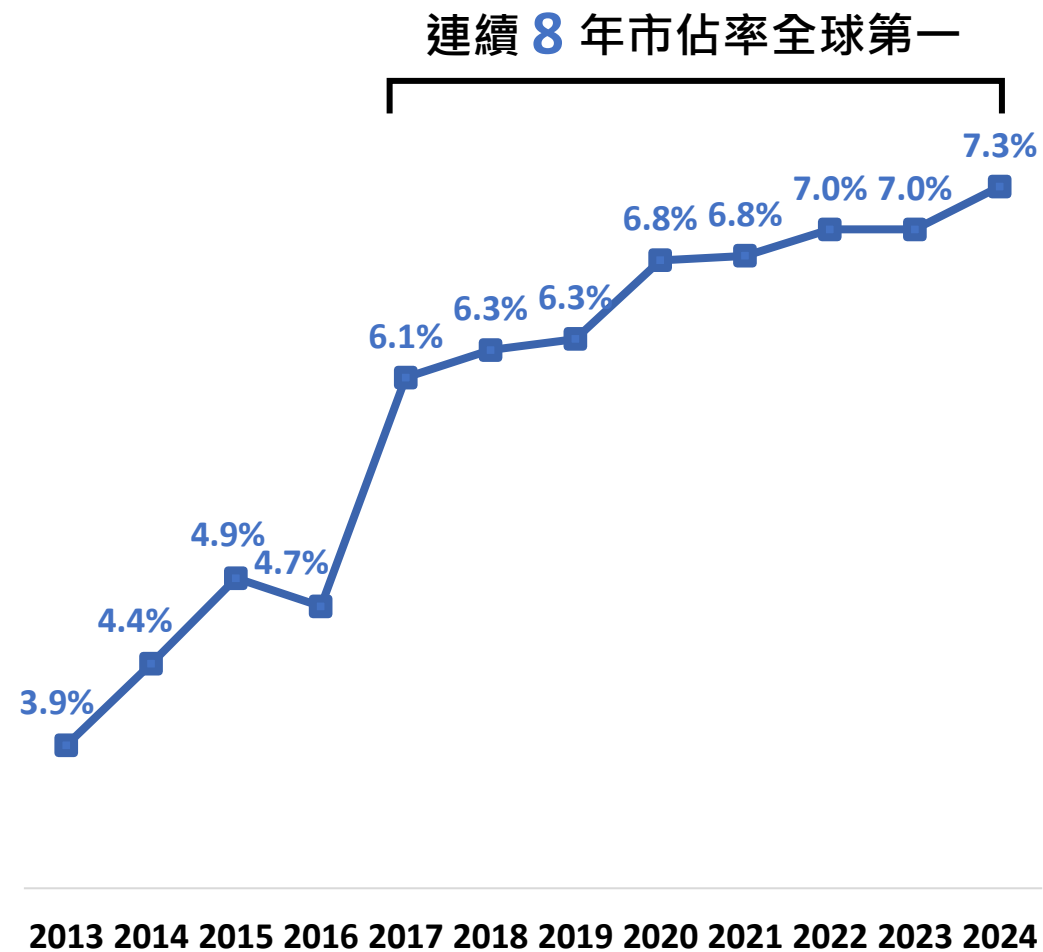
簡禎富總經理將運用過去豐富的學界與產業歷練，協助臻鼎在五大方面加速發展，包含：智慧製造、工業工程、AI賦能、半導體產業鏈結、及產學合作研究。臻鼎經營團隊將由董事長暨集團策略長擘畫經營戰略布局、總經理推動數位轉型與賦能、營運長負責營運管理與執行的經營鐵三角，提升經營效益並加速轉型。

2024年全球前十大PCB領導廠商營收趨勢



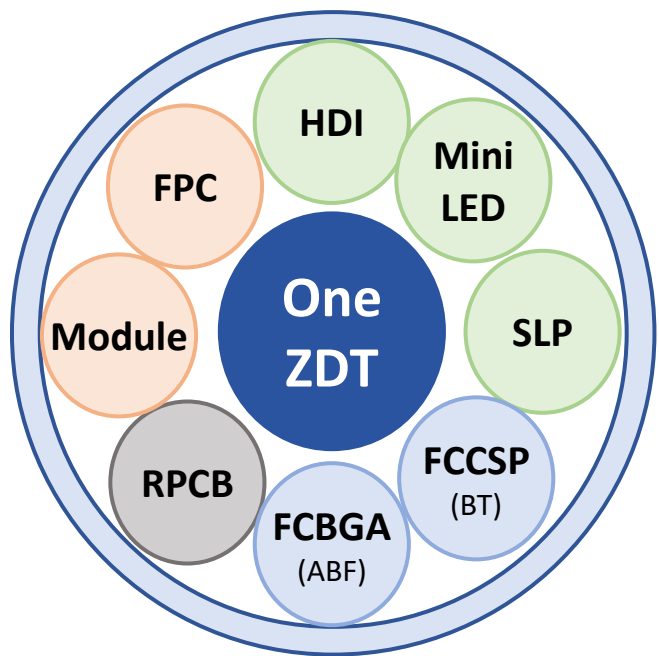
資料來源：NT Information；Prismark (2025/03)

臻鼎持續保持PCB產業領先市佔率



資料來源：Prismark

從AI終端裝置至AI伺服器 – AI應用朝多元化發展，將使PCB板設計趨於複雜
臻鼎提供業界最完整與先進的PCB產品，打入AI相關的全方位應用

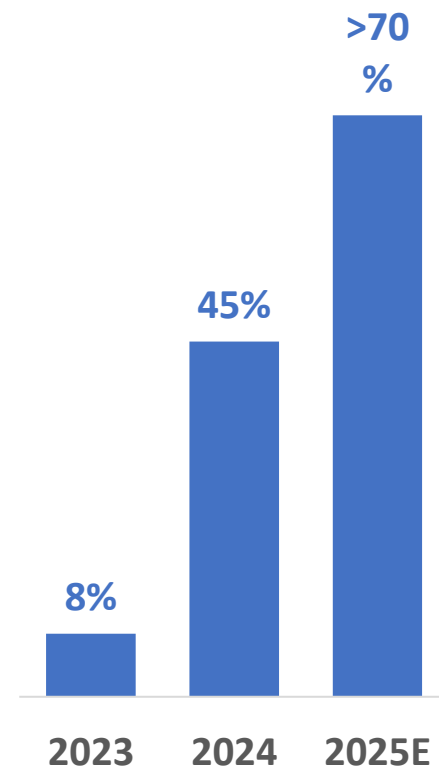


AI



AI 伺服器	邊緣運算 伺服器	高速運算 記憶體	
光通訊	交換器	基地台	
AI 手機/ 晶片	AI PC	AI 平板	智能穿戴
AR/VR 元宇宙	智能車用 智慧座艙 域控制器	自動駕駛 車用晶片	新能源車 電池板

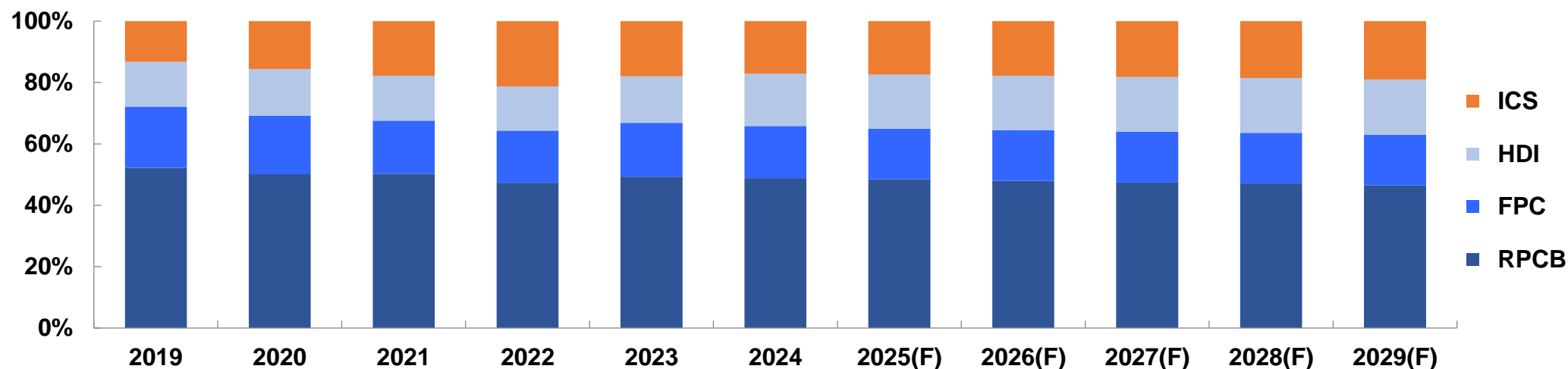
■ 臻鼎AI營收占比



發揮One ZDT綜效，持續拉開領先差距

目標2030年全球PCB市佔率達10%

2025年各類PCB市場規模將持續成長



產品	項目	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025(F)	2026(F)	2027(F)	2028(F)	2029(F)	2024-2029 CAGR
RPCB	產值	31,969	32,674	40,641	38,720	34,292	35,941	38,091	39,471	40,823	42,679	44,022	4.1%
	佔全球比	52.1%	50.1%	50.2%	47.4%	49.3%	48.9%	48.5%	48.0%	47.4%	47.1%	46.5%	
FPC	產值	12,195	12,483	14,058	13,842	12,191	12,504	12,960	13,579	14,227	14,906	15,617	4.5%
	佔全球比	19.9%	19.1%	17.4%	16.9%	17.5%	17.0%	16.5%	16.5%	16.5%	16.5%	16.5%	
HDI	產值	9,008	9,874	11,811	11,763	10,536	12,518	13,815	14,558	15,342	16,167	17,037	6.4%
	佔全球比	14.7%	15.1%	14.6%	14.4%	15.2%	17.0%	17.6%	17.7%	17.8%	17.9%	18.0%	
ICS	產值	8,139	10,188	14,410	17,415	12,498	12,602	13,696	14,661	15,695	16,801	17,985	7.4%
	佔全球比	13.3%	15.6%	17.8%	21.3%	18.0%	17.1%	17.4%	17.8%	18.2%	18.6%	19.0%	
合計		61,311	65,219	80,920	81,740	69,517	73,565	78,562	82,269	86,087	90,553	94,661	5.2%
年增率		-1.7%	6.4%	24.1%	1.0%	-15.0%	5.8%	6.8%	4.7%	4.6%	5.2%	4.5%	

資料來源：Prismark(2025/3)；2026~2028年係用Prismark數據推估。

1

2025年伺服器、車載、光通訊營收持續看增。其中伺服器方面，AI伺服器為成長主力：

臻鼎由通用型伺服器成功切入AI伺服器領域，通過對於關鍵製程的掌握，獲得AI伺服器穩定訂單提供營收成長動能。現持續擴大與客戶在Intel/AMD/ASIC 三大架構案件開發。配合現有兩大雲端客戶AI ASIC相關產品發展規劃，臻鼎提供PCB完整方案並加速全球生產佈局。

2

光通訊方面，以高階產品搶攻市場：

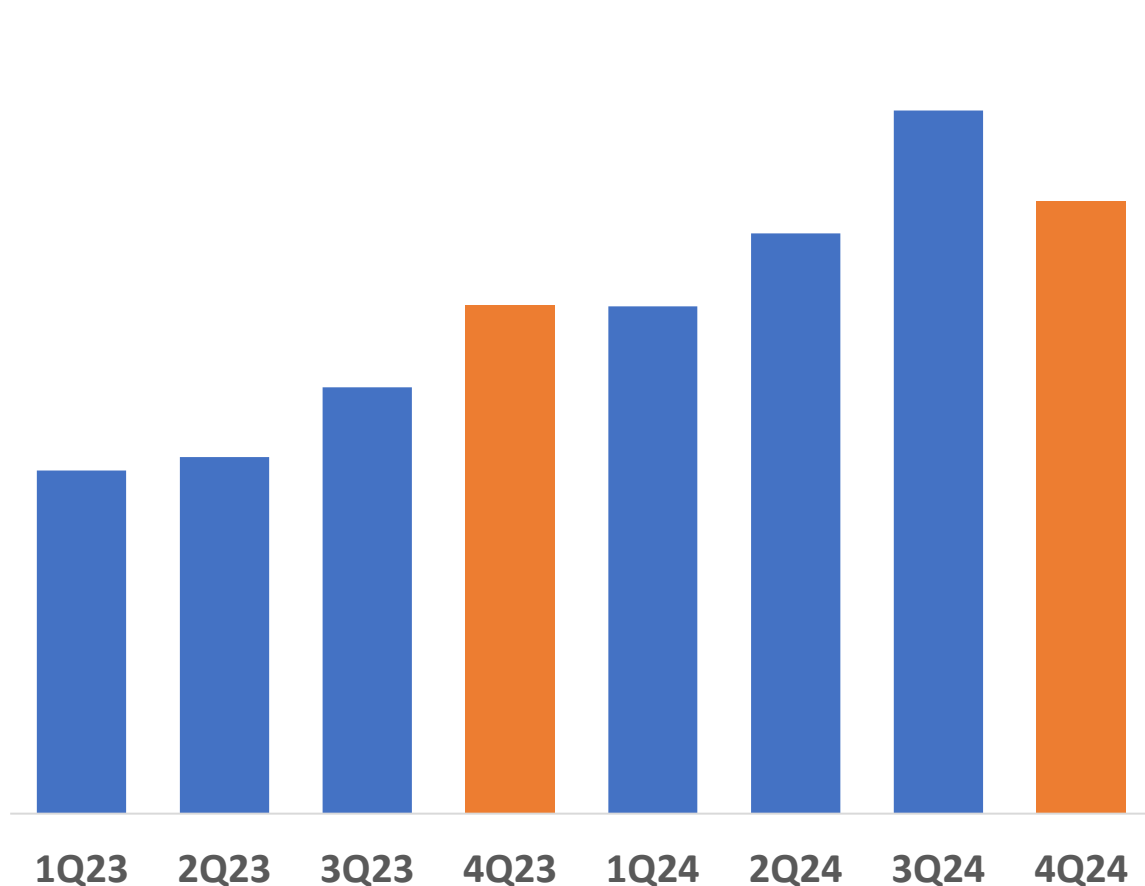
光通訊產品去年陸續通過客戶認證後已進入量產，營收貢獻將逐步提高，同時今年以800G/1.6T高階mSAP設計為主，將新增更多客戶與訂單，3.2T產品也開始進入研發設計階段。隨AI持續深化發展，高階產品需求增長以mSAP需求為主力，未來3-5年保持高成長性。

3

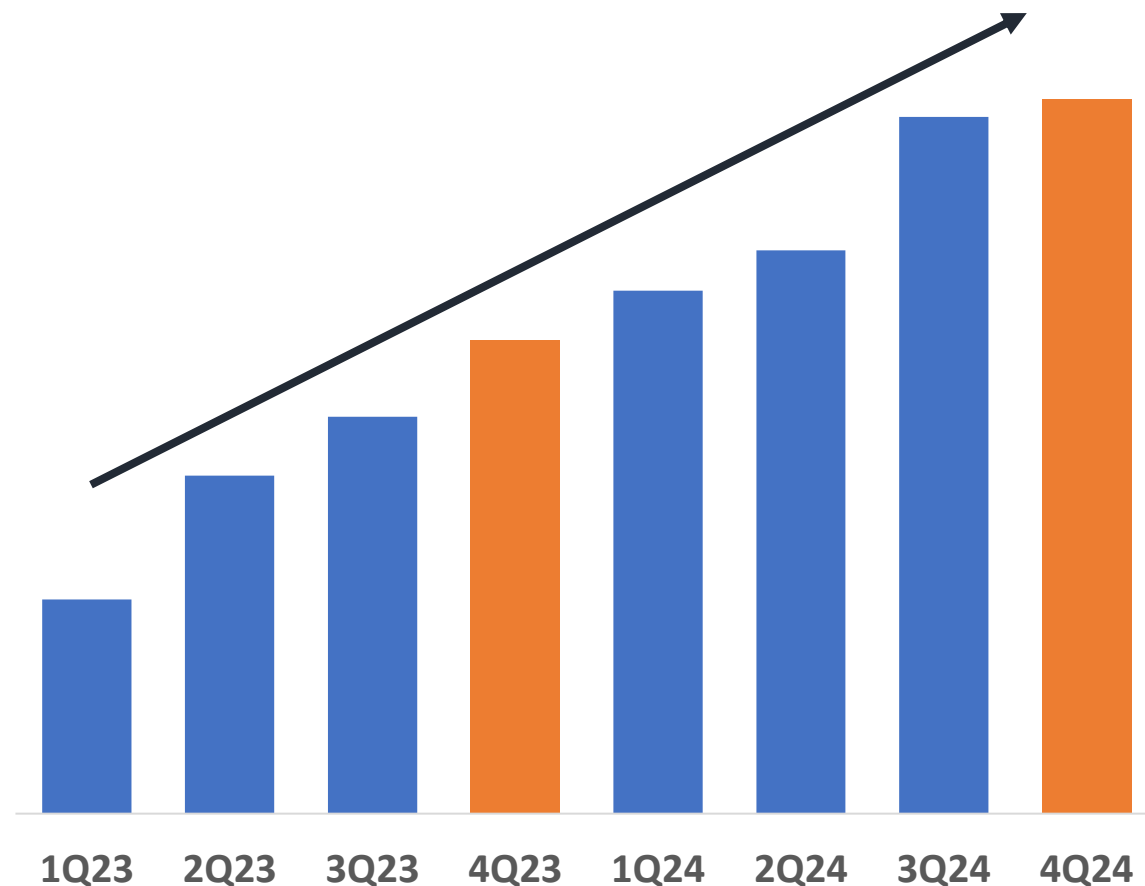
車載方面，智駕與電動化佈局持續成長：

臻鼎積極布局汽車智駕化高階多層HDI 產品，ADAS 域控主板及高階傳感器已量產。電動化部分，動力電池相關產品出貨量持續成長。車用互聯化部分也隨客戶開發，將會有高階SLP應用出現。下半年起客戶將陸續驗證泰國園區，滿足客戶多元製造基地的需求。

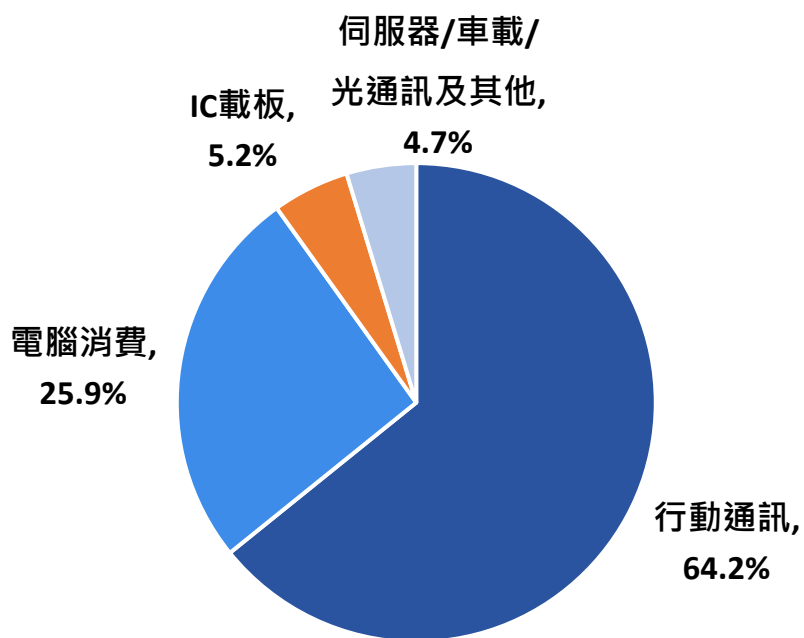
臻鼎伺服器/車載/光通訊營收持續雙位數年增



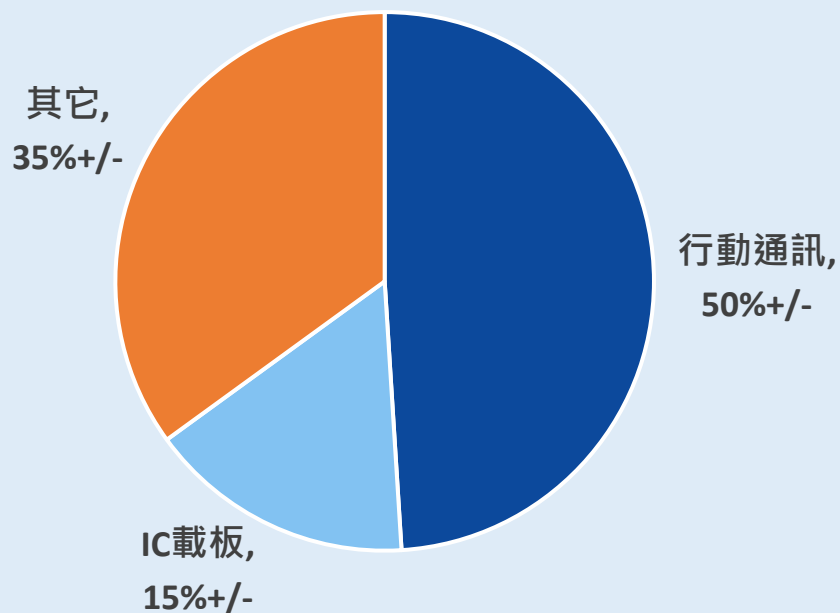
臻鼎IC載板營收續創單季新高



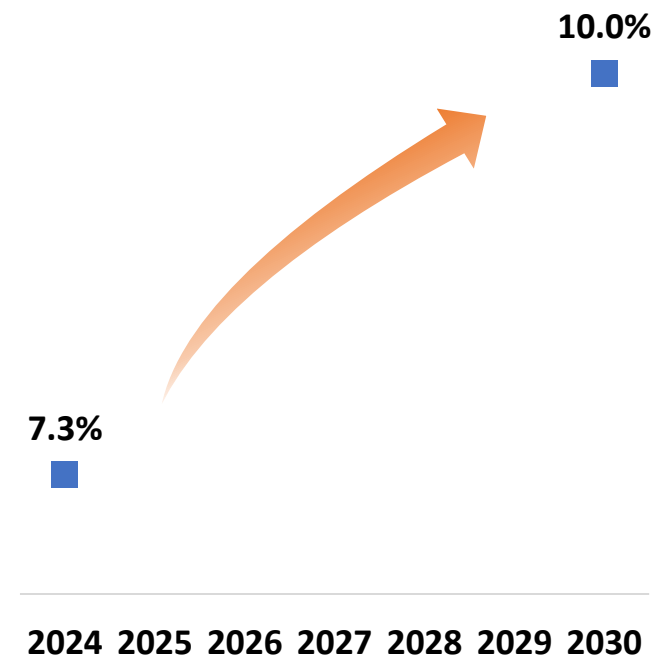
2024年營收新台幣1,717億



2027年目標營收產品應用比重



2030年目標全球市佔率達10%



積極拓展IC載板業務

目標2030年成為全球前五大

1

2024年IC載板營收年增75.6%，增速大幅優於產業平均成長：

- 臻鼎的IC載板產能以高階產品為主，其中ABF載板受惠於Chiplet以及2.5D先進封裝產品的需求，產能利用率在2024年大幅提升，同時BT載板營收亦穩步提升，整體IC載板營收增速大幅優於產業平均。

2

2025年，IC載板預計仍將是臻鼎四大產品應用中成長最快的業務部門：

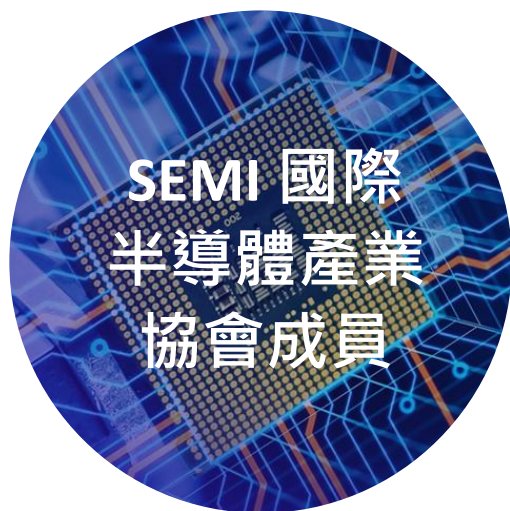
- 整體ABF載板市場雖然價格復甦緩慢，但受惠於AI、高速運算與先進封裝技術的快速發展，高階ABF載板在大尺寸(70mm*70mm以上)及高層數(16層以上)產品需求持續成長。臻鼎ABF載板持續新技術平台產品的開發，待客戶認證通過後會於下半年可望開始貢獻營收，今年產能利用率將較去年再往上提升。

3

將於高雄AI園區以智慧工廠2.0概念，打造先進的IC載板生產基地：

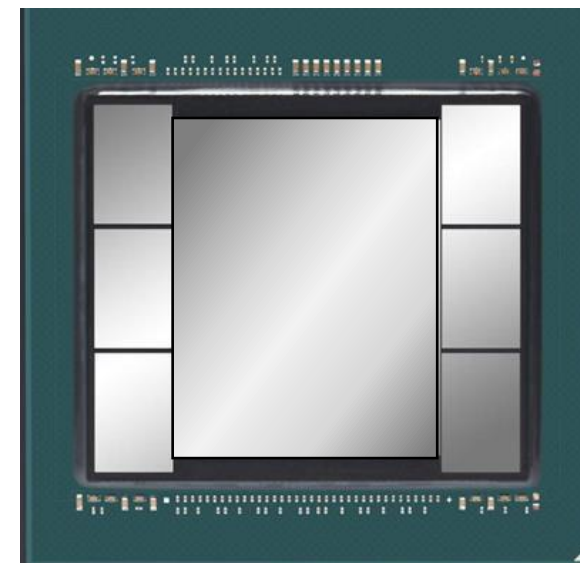
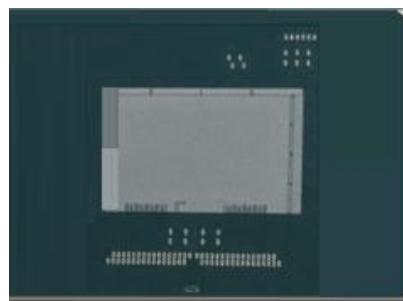
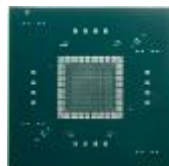
- 因應未來客戶高階產品需求，公司規劃於高雄AI園區建置全流程之先進封裝用FCBGA量產場域，預計開發FCBGA全流程生產設備及內埋流程生產設備，打造先進的IC載板生產基地。

臻鼎積極參與半導體產業相關組織，與上下游企業密切合作，拓展在新興技術領域的市場機會。



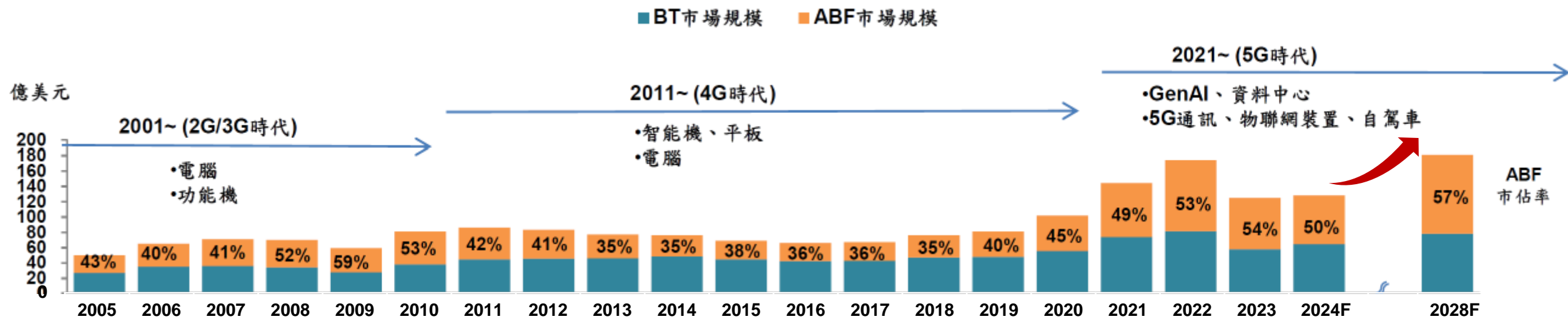
IC載板的複雜程度提升：

層數**高**、
尺寸**大**、
表面**平**、
產品精度**準**



	2005	2020	2026	
Body Size (mm)	31 x 31	75 x 60	120 x 140+	x20+
Layer count (L)	6	20	28+	x4+
Bump Count	1K	100K	300k+ ~ 500k+	x300+

AI新應用驅動高階載板需求動能



Source: Prismark (2024/9)



先進封裝趨勢

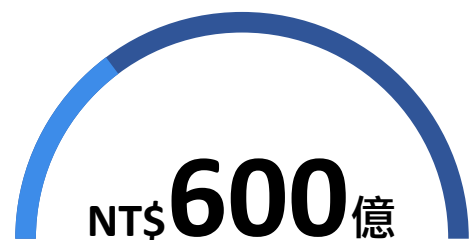
- Chiplet及HBM增加，Bump Area設計會更不規則，對封裝良率要求更嚴格
- 尺寸變大、高層板複雜線路會需求增加
- 封裝良率更複雜，載板作為最重要的元器件，品質要求至關重要
- 車載產品將大量應用先進封裝技術，對載板和關鍵材料有新需求

先進Chiplet趨勢

- Interposer變大，Bump Counts增加，大尺寸高層板高階化
- 光電器件是未來必要的趨勢，載板邊緣也會有大量的Bump和佈線、疊孔
- Wafer背部供電，將改變Substrate和封裝結構

Co-Packaged Optics (CPO)

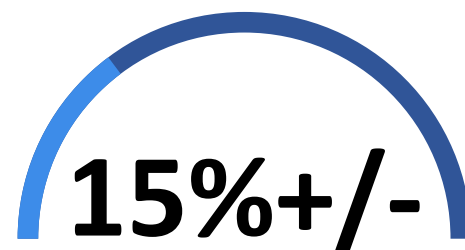
- CPO是大勢所趨，目前共識最好的載體還是Substrate
- 光電共封CPO能夠提升傳輸效率，並且能夠降低能耗和信號損失
- 關注CPO+CoWoS共封技術



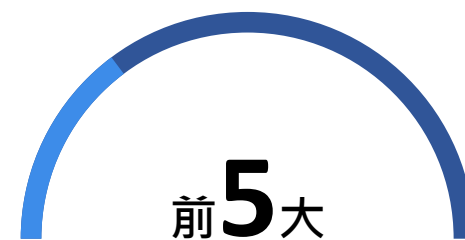
IC載板資本支出：
2022-2027規劃投資
600億



IC載板營收：
2023-2027複合
成長率 >50%



IC載板營收：
至2027年，IC載板占
臻鼎合併營收15%+/-



IC載板市占率：
目標2030年成為IC
載板全球前五大

全球化生產基地

多廠區生產基地，貼近客戶需求

印度



清奈園區

- ▶ FPC先進模組

泰國



巴真府園區

- ▶ 預計1H25試產

中國大陸 深圳



深圳第一園區

- ▶ FPC與先進模組/HDI



深圳第二園區

- ▶ FPC先進模組



ABF載板園區

- ▶ 第一期2023年量產

中國大陸 秦皇島



秦皇島園區

- ▶ FPC與先進模組 /SLP高階 HDI



BT載板園區

- ▶ FC-CSP/WB-CSP/Memory 第一期2022年量產

中國大陸 淮安



淮安第一園區

- ▶ RPCB/HDI



淮安第二園區

- ▶ FPC與先進模組 /HDI/Mini LED 背光 超薄細線路電路板



淮安第三園區

- ▶ 高階 HDI/MSAP 2023年量產

台灣



高雄AI園區

- ▶ AI產品之研發暨 生產據點



桃園先豐通訊園區

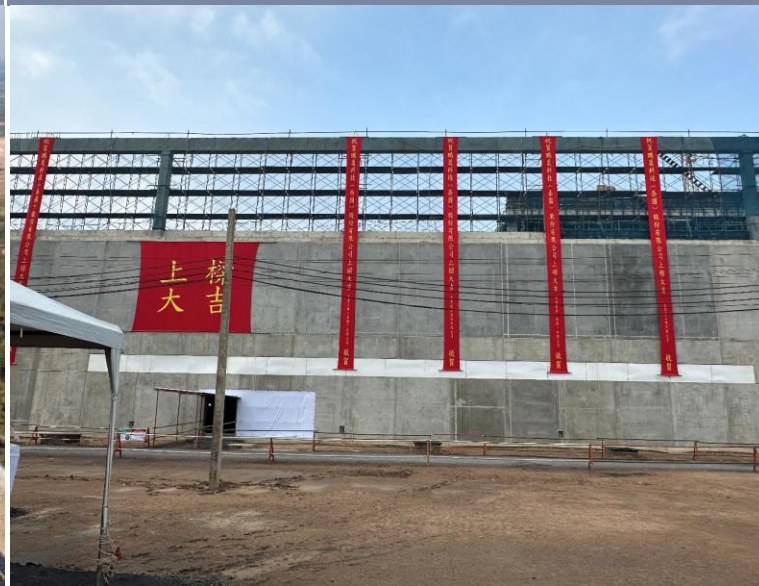
- ▶ 網通、高速運算、汽車等相關領域之印刷電路板

泰國新廠第一期按計畫建設中，將於5/8試產

(2023年12月)泰國巴真府園區第一期



(2024/8/26) 上樑典禮



(2025年2月) 泰國園區現況

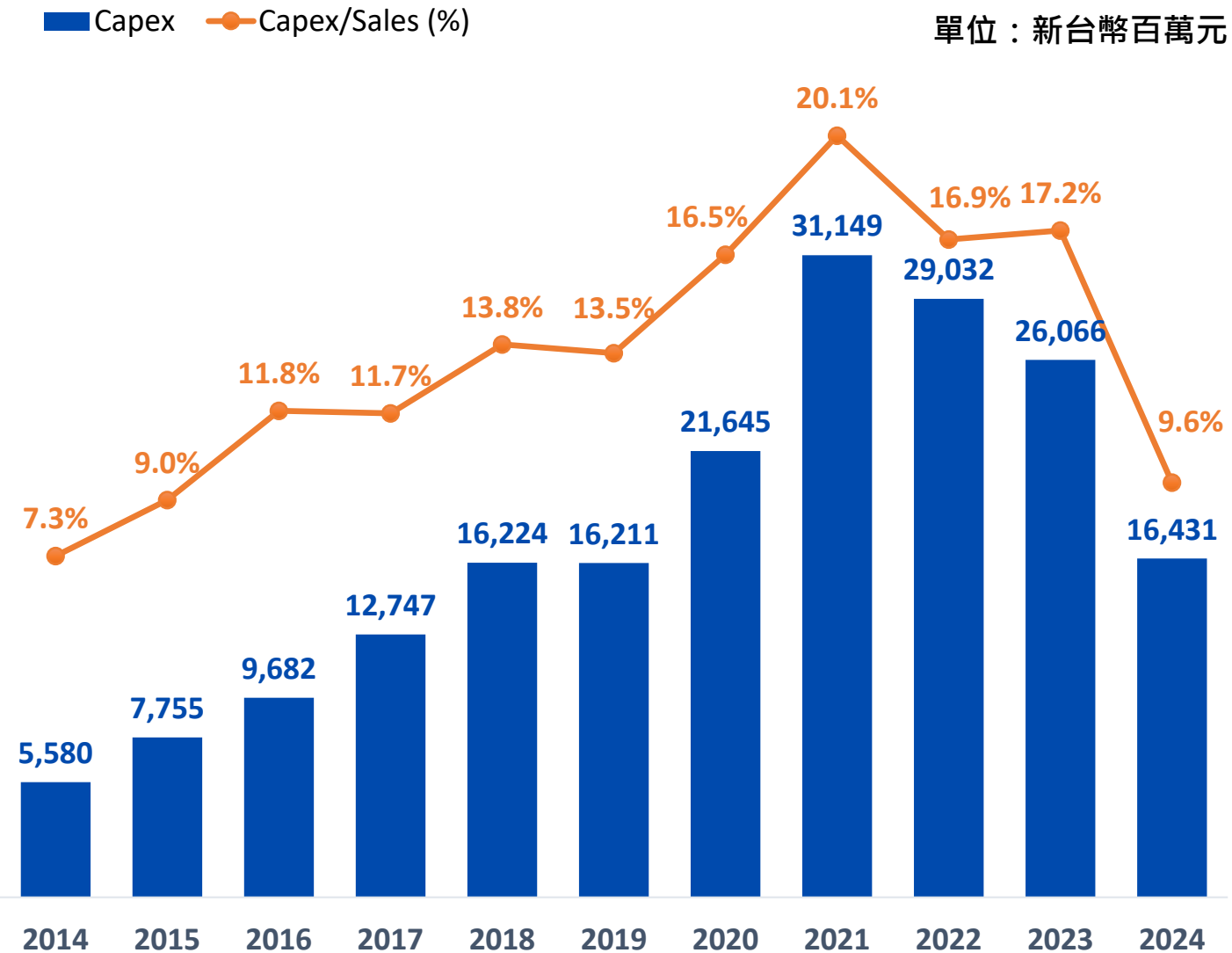


- 泰國巴真府新廠第一期已於2月開始進機，將於5/8試產、下半年小量產，同時第二期廠房亦將於5/8動土
- 第一期產能將以高階伺服器/車載/光通訊相關應用為主，提供高階RPCB/HDI產品
- 目前公司積極投入資源、開拓新產品，爭取在泰國產能投產後順利切入更多一線客戶

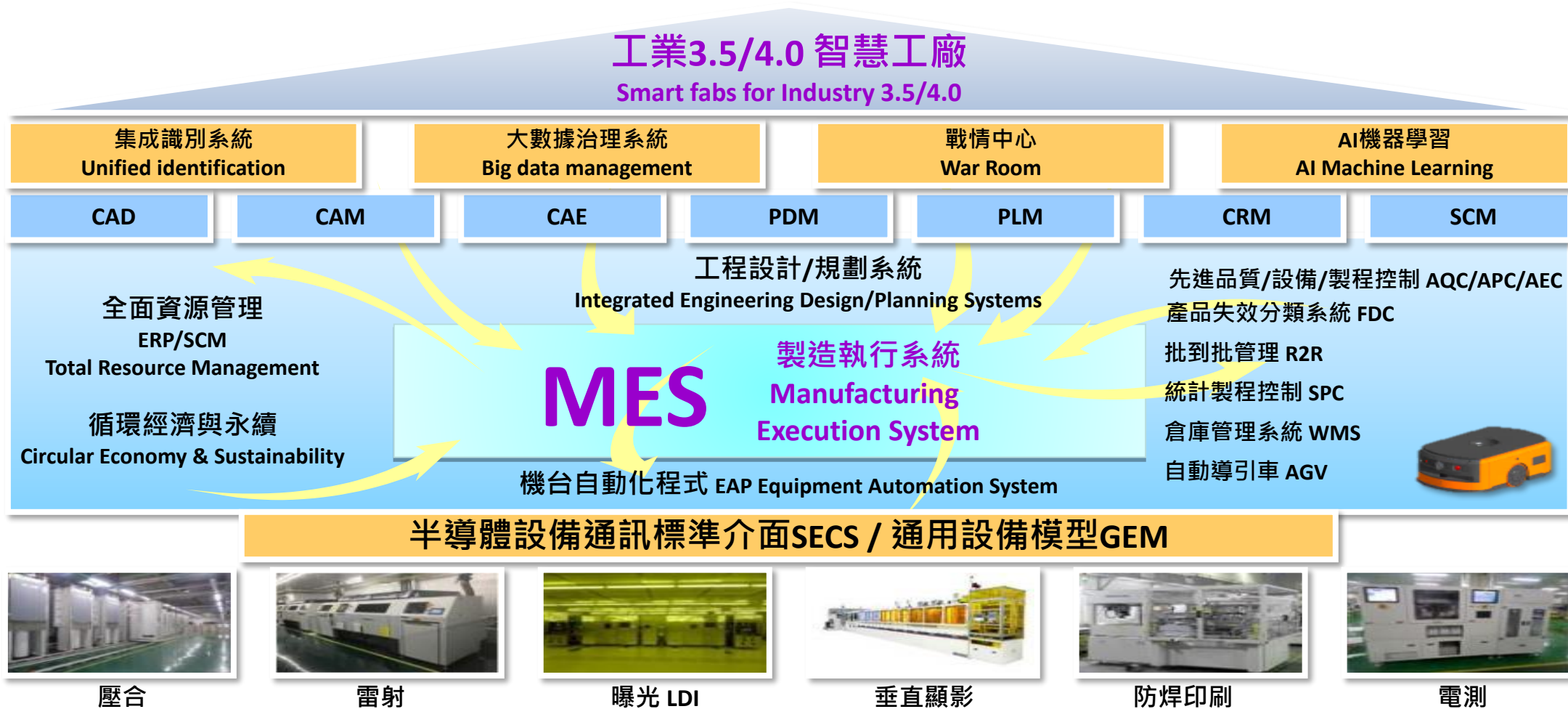


高雄AI園區是臻鼎對應AI市場需求重要的研發暨生產據點，將專注提供高階產品，其中：

- IC載板：已公告預計投入新台幣80億元購置設備，建置全流程之先進封裝用FCBGA量產場域。
- 高層數及高密度 (HLC+HDI) PCB：已公告預計投入新台幣20億元購置設備、建置產能。
- 軟板產線：已進入試產。



- 身為全球第一大PCB製造商，臻鼎仍定位自身為成長型企業，持續以「糧草先行」策略，及早布局客戶所需產能。
- 今年將持續投入大陸與海外產能擴充。大陸方面，臻鼎不僅將擴充車載及儲能軟板產能，園區亦將配合客戶建置去瓶頸所需高階產能。海外方面則按計畫執行高雄廠與泰國廠的建置，為長期成長奠定基礎。





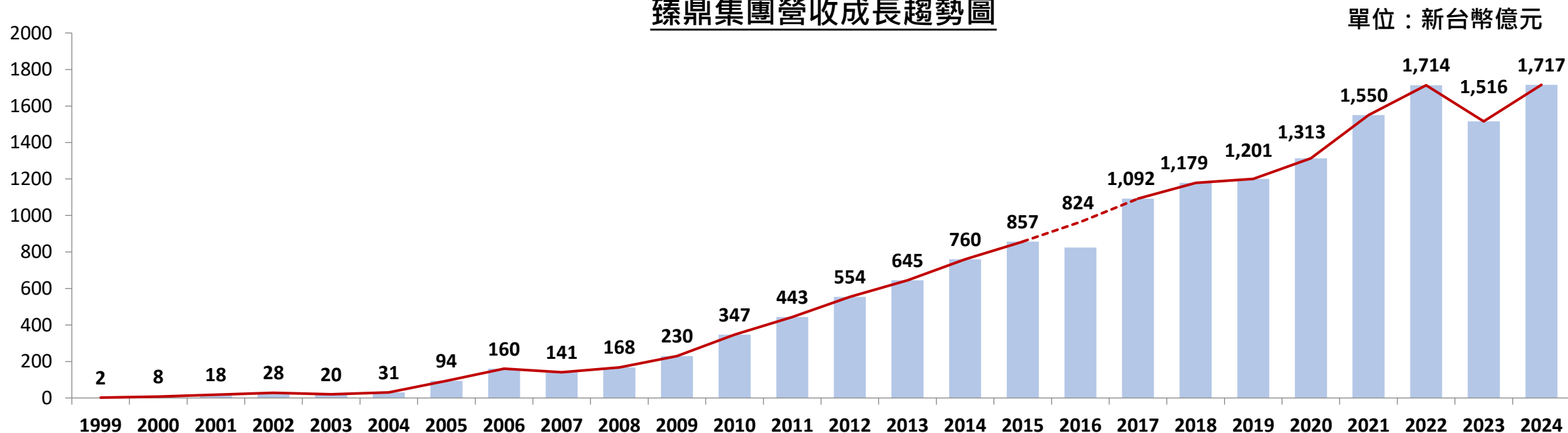
在One ZDT 策略下，各廠區分階段導入智能管理，截至2024年底，已有9座新廠導入智能管理，另有6座舊廠升級，廠房導入智能管理後在良率及效率上都有顯著效益。目前29座工廠中，有4座興建中、1座升級中，另有9座舊廠待改善。



目標持續提高單位人均產值

- ▶ 透過數位轉型與智慧工廠提升營運效率，目標在2030年前營收持續增長，同時強化人力規模的掌控，確保單位人均產值有效提升。

臻鼎集團營收成長趨勢圖



單位：新台幣億元；人

年度	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
營收	2	8	18	28	20	31	94	160	141	168	230	347	443	554	645	760	857	824	1,092	1,179	1,201	1,313	1,550	1,714	1,516	1,717
員工	/	/	/	/	/	3,396	4,605	8,805	13,006	17,009	18,142	22,983	23,034	25,392	27,820	33,212	37,801	39,943	40,622	38,588	35,953	40,521	44,330	42,425	41,478	49,149

註：年平均員工人數

▶ 臺灣公司治理評鑑

2024年公司治理評鑑排名上市公司6%-20%，再度入選臺灣證券交易所公司治理100指數。

▶ 標普全球企業永續評鑑 S&P Global ESG

2024年S&P Global ESG 評級進步至78分，連續3年入選標普全球永續年鑑 (Sustainability Yearbook)，為台灣唯一入選的PCB企業。

▶ Sustainalytics ESG 風險評級

最新Sustainalytics ESG風險評級為15.7，為低等風險等級。

▶ ISS ESG 評級

最新年度的ISS ESG評級由「C」進步至「C+」，獲得「優秀(Prime)」等級。

▶ CDP 碳揭露專案

2024年在水安全管理獲得「A」最高等級殊榮，較去年進步一等級。在氣候變遷獲得「B」等級。

▶ 富時羅素 FTSE Russell ESG

最新年度的FTSE Russell ESG評級獲得4.4分（滿分為5分），成為台灣上市櫃公司並列第五名。



臻鼎科技控股

Zhen Ding Tech. Holding

營運成果摘要

單位: 新台幣佰萬元, 除另予註明者外

	4Q24	4Q23	年變化 (%)
營業收入	56,133	54,396	+3.2%
營業毛利	11,471	11,679	-1.8%
營業毛利率	20.4%	21.5%	-1.1ppts
營業費用	5,917	5,424	+9.1%
營業利益	5,554	6,254	-11.2%
營業利益率	9.9%	11.5%	-1.6ppts
營業外收入及支出	2,206	(409)	
本期淨利	6,242	5,070	+23.1%
淨利率	11.1%	9.3%	+1.8ppts
歸屬於母公司之淨利	4,363	3,504	+24.5%
每股盈餘 (新台幣元) ⁽¹⁾	4.59	3.71	
研發費用	3,048	2,866	+6.3%
折舊及攤銷	4,655	4,199	+10.8%
營運活動之現金流入	20,933	13,239	+58.1%
現金及約當現金 ⁽²⁾	79,830	65,970	+21.0%
股東權益報酬率 (%) ⁽³⁾	17.4%	15.2%	+2.2ppts

附註：(1) 2024年度加權平均流通在外股數為949,394仟股 (實際發行股本956,653仟股-庫藏股2,093仟股)。 (2) 現金及約當現金包含按攤銷後成本衡量之金融資產的定期存款等。 (3) 股東權益報酬率為以母公司股東平均股權計算的年化數據。

2024年全年營運成果

單位: 新台幣佰萬元, 除另予註明者外

	2024	2023	年變化 (%)
營業收入	171,664	151,398	+13.4%
營業毛利	32,461	27,459	+18.2%
營業毛利率	18.9%	18.1%	+0.8ppts
營業費用	20,875	18,300	+14.1%
營業利益	11,586	9,160	+26.5%
營業利益率	6.8%	6.1%	+0.7ppts
營業外收入及支出	3,459	888	+289.5%
本期淨利	13,096	9,432	+38.9%
淨利率	7.6%	6.2%	+1.4ppts
歸屬於母公司之淨利	9,180	6,189	+48.3%
每股盈餘 (新台幣元) ⁽¹⁾	9.67	6.55	
研發費用	11,715	9,665	+21.2%
折舊及攤銷	17,749	16,323	+8.7%
營運活動之現金流入	30,385	33,599	-9.6%
現金及約當現金 ⁽²⁾	79,830	65,970	+21.0%
股東權益報酬率 (%) ⁽³⁾	9.1%	7.1%	+2.0ppts

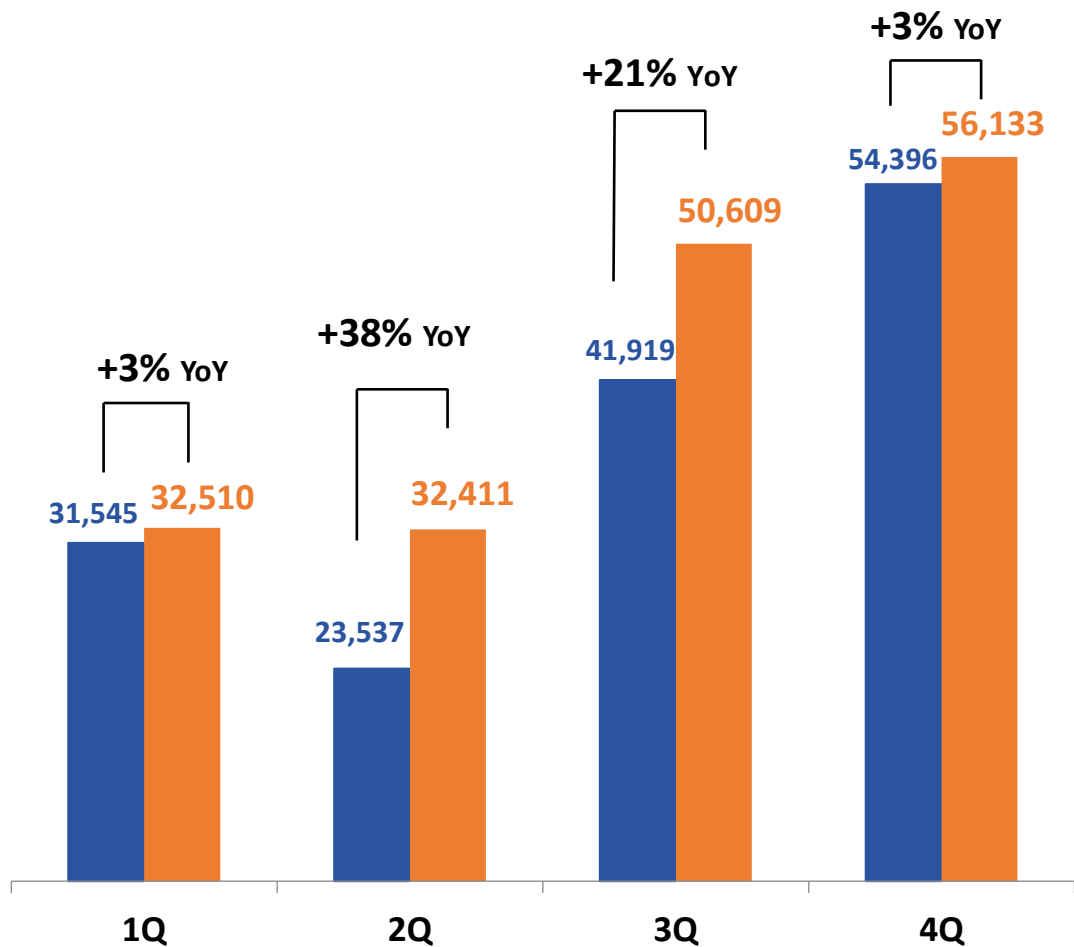
附註：(1) 2024年度加權平均流通在外股數為949,394仟股 (實際發行股本956,653仟股-庫藏股2,093仟股)。 (2) 現金及約當現金包含按攤銷後成本衡量之金融資產的定期存款等。 (3) 股東權益報酬率為以母公司股東平均股權計算的年化數據。

營業收入

■ 2023

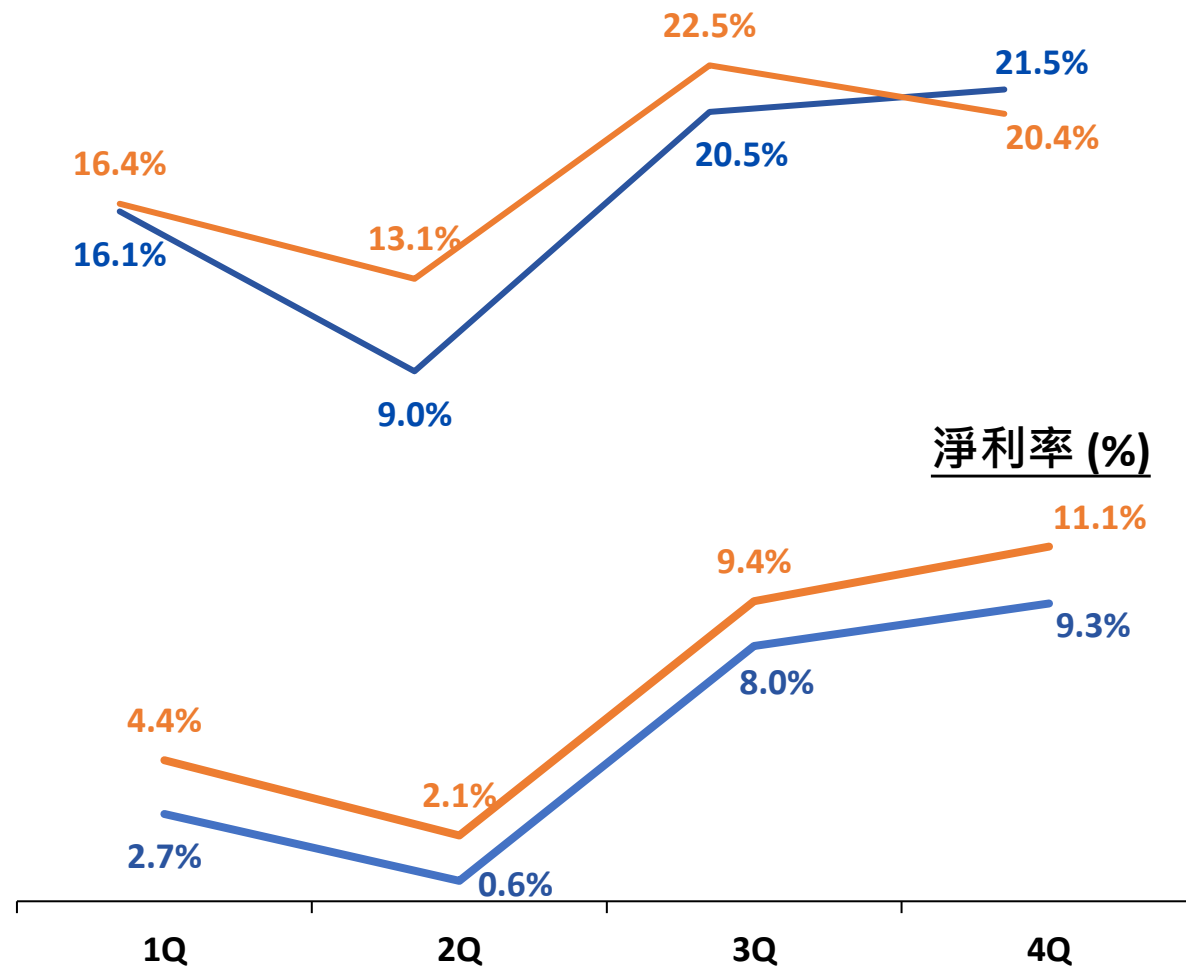
■ 2024

單位：新台幣佰萬元

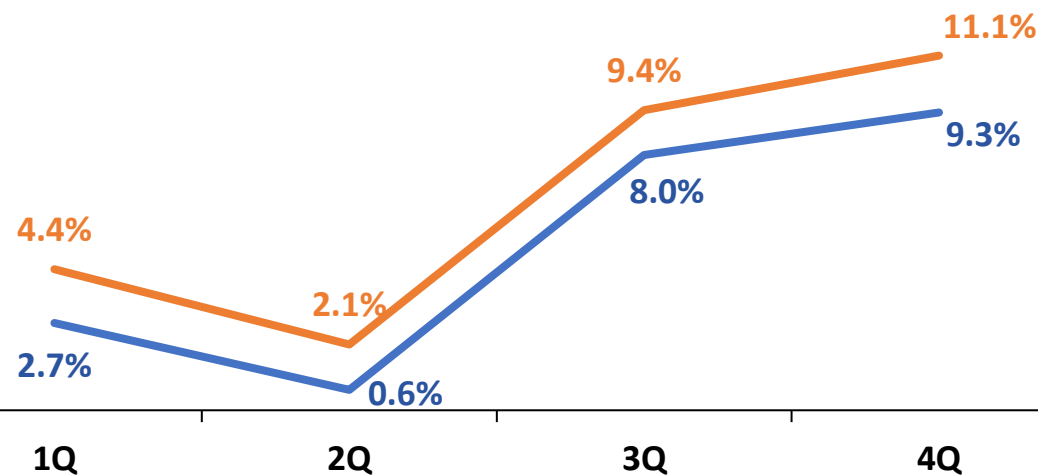


毛利率 (%)

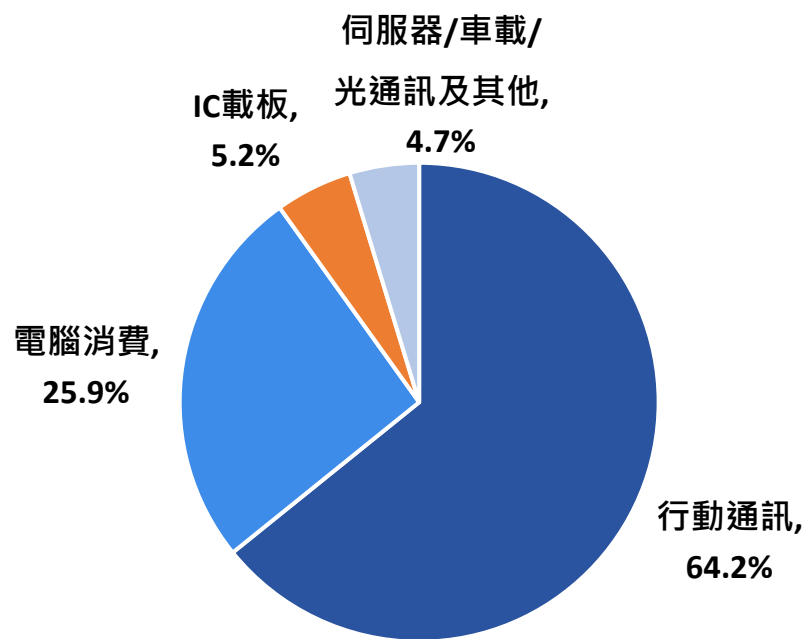
— 2023 — 2024



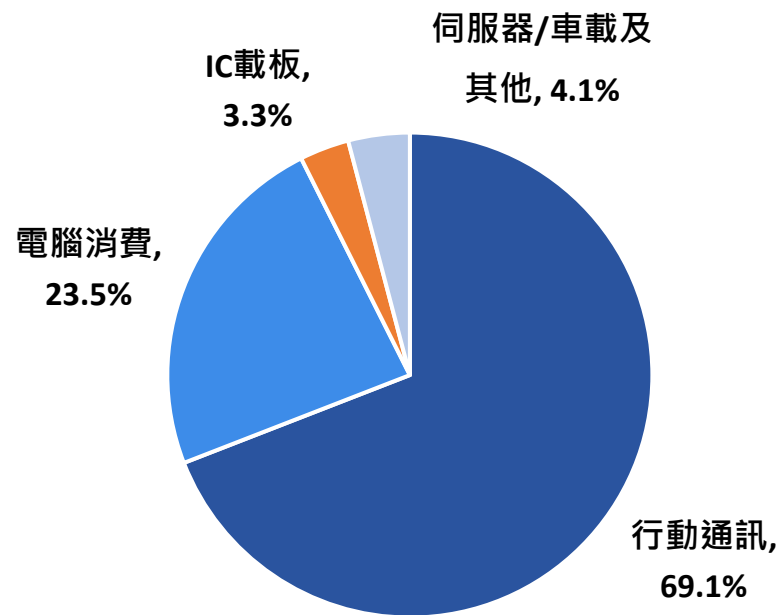
淨利率 (%)



2024年營收新台幣1,717億



2023年營收新台幣1,514億



產品別	2024年營收YoY%
行動通訊	5.5%
電腦消費	24.8%
IC載板	75.6%
伺服器/車載/光通訊及其他	30.9%

資產負債表及重要財務比率

	2024-12-31		2023-12-31		單位：新台幣佰萬元 差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
現金及約當現金 ⁽²⁾	79,830	30.0%	65,970	27.2%	13,860	2.8ppts
應收款項	30,959	11.6%	29,503	12.2%	1,455	-0.5ppts
存貨	17,990	6.8%	15,508	6.4%	2,482	0.4ppts
不動產、廠房及設備 ⁽³⁾	113,462	42.7%	109,965	45.3%	3,497	-2.6ppts
資產總額	265,993	100.0%	242,932	100.0%	23,218	
借款	57,051	21.4%	53,130	21.9%	3,922	-0.4ppts
應付款項	40,858	15.4%	37,853	15.6%	3,004	-0.2ppts
負債總額	113,970	42.8%	108,450	44.7%	5,520	-1.8ppts
股東權益總額	152,024	57.2%	134,326	55.3%		
重要財務比率						
平均收現日數(天)	63		72		(9)	
平均銷貨日數(天)	47		52		(5)	
流動比率(倍)	1.91		1.44		0.47	
資產生產力(倍) ⁽⁴⁾	1.59		1.47		0.12	

附註：(1) 2024年度加權平均流通在外股數為949,394仟股 (實際發行股本956,653仟股-庫藏股2,093仟股)。 (2) 現金及約當現金包含按攤銷後成本衡量之金融資產的定期存款等。(3) 不動產、廠房及設備 包含 投資性不動產。(4) 資產生產力 = 年化營業收入淨額 / 平均不動產、廠房及設備淨額。

單位：新台幣佰萬元

年度	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
營業收入	85,738	82,393	109,238	117,913	120,068	131,279	155,022	171,356	151,398	171,664
營業毛利	16,427	12,542	17,833	26,061	27,222	26,584	30,537	39,888	27,459	32,461
本期淨利	7,731	3,456	6,772	11,536	12,402	11,508	13,694	20,535	9,432	13,096
母公司淨利	7,731	3,456	5,172	8,448	8,685	8,095	9,651	14,197	6,189	9,180
折舊及攤銷	4,850	5,295	5,679	6,820	7,955	8,405	11,875	14,638	16,323	17,749
每股盈餘 (元)	9.80	4.29	6.43	10.50	9.93	8.90	10.21	15.02	6.55	9.67
每股股利 (元)	4.50	2.20	3.30	4.46	4.50	4.50	5.00	6.00	3.275	4.80
分派比率 (%)	46%	51%	51%	43%	45%	51%	49%	40%	50%	50%
現金及約當現金 *	31,572	30,241	33,296	49,154	43,071	46,775	35,179	57,599	65,970	79,830
不動產、廠房及設備	32,074	32,262	36,681	41,913	46,243	68,177	86,073	104,814	109,965	113,462
資本額	8,047	8,047	8,047	8,047	9,022	9,470	9,470	9,470	9,470	9,567
股東權益報酬率 (%)	20.82%	8.59%	14.49%	17.30%	14.72%	11.84%	12.59%	16.67%	7.10%	9.15%
負債比率 (%)	53.70%	59.72%	55.33%	44.25%	35.41%	42.56%	42.01%	42.87%	44.67%	42.85%

* 現金及約當現金包含按攤銷後成本衡量之金融資產的定期存款等



臻鼎科技控股

Zhen Ding Tech. Holding

Q&A



THANK YOU